日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年 7月16日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-207495

[ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 2 - 2 0 7 4 9 5]

出 願 人
Applicant(s):

古河電気工業株式会社

 J_i^N

2003年 8月 1日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

A20350

【提出日】

平成14年 7月16日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01S 5/00

H01S 3/18

H04B 10/16

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

大木 泰

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

築地 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

吉田 順自

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

清水 裕

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

早水 尚樹

【特許出願人】

【識別番号】

000005290

【氏名又は名称】 古河電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100089118

【弁理士】

【氏名又は名称】 酒井 宏明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

036711

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0103421

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体レーザ装置、半導体レーザモジュールおよびこれを用いたラマン増幅器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光の出射端面に設けた第1反射膜と該レーザ光の反射端面に設けた第2反射膜との間に形成された活性層を有し、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導体レーザ装置において、

前記活性層に注入されるバイアス電流を変調する変調信号を生成し、該変調信号を前記バイアス電流に重畳する変調手段を備え、

前記変調手段は、前記レーザ光の変調によってレイリー散乱レベルに2dB加 えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴と する半導体レーザ装置。

【請求項2】 前記変調手段は、前記レーザ光の変調によってレイリー散乱 レベルに1dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与 えることを特徴とする請求項1に記載の半導体レーザ装置。

【請求項3】 前記活性層の近傍に回折格子を設け、前記活性層が形成する 共振器長と該回折格子の波長選択特性とを含む発振パラメータの組み合わせ設定 によって発振波長スペクトルの半値幅内に複数の発振縦モードを生成することを 特徴とする請求項1または2に記載の半導体レーザ装置。

【請求項4】 レーザ光の出射端面に設けた第1反射膜と該レーザ光の反射端面に設けた第2反射膜との間に形成された活性層を有し、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導体レーザ装置において、

前記複数の発振縦モードの最大光強度に対する差分値が10dB以下である高 出力発振縦モードを複数選択する回折格子を備え、

前記回折格子は、前記高出力発振縦モードの選択本数によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項5】 前記回折格子は、前記高出力発振縦モードの選択本数によってレイリー散乱レベルに1dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリ

ターンロスを与えることを特徴とする請求項4に記載の半導体レーザ装置。

【請求項6】 レーザ光の出射端面に設けた第1反射膜と該レーザ光の反射端面に設けた第2反射膜との間に形成された活性層を有し、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導体レーザ装置と、

前記半導体レーザ装置から出射されたレーザ光を外部に導波する光ファイバと

前記半導体レーザ装置と前記光ファイバとの光結合効率が最大となる位置からずれた状態で前記半導体レーザ装置と前記光ファイバとの光結合を行う光結合レンズ系と、

を備え、前記光結合効率の減衰によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする半導体レーザモジュール。

【請求項7】 レーザ光の出射端面に設けた第1反射膜と該レーザ光の反射端面に設けた第2反射膜との間に形成された活性層を有し、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導体レーザ装置と、

前記半導体レーザ装置から出射されたレーザ光を外部に導波する光ファイバと

前記レーザ光を減衰させる光減衰器と、

を備え、前記光減衰器の減衰によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする半導体レーザモジュール。

【請求項8】 前記光結合効率または前記光減衰器の減衰によってレイリー散乱レベルに1dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする請求項6または7に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項9】 前記活性層の近傍に回折格子を設け、前記活性層が形成する 共振器長と該回折格子の波長選択特性とを含む発振パラメータの組み合わせ設定 によって発振波長スペクトルの半値幅内に複数の発振縦モードを生成することを 特徴とする請求項6~8のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュール。

【請求項10】 請求項1~5のいずれか一つに記載の半導体レーザ装置あ

るいは請求項6~9のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュールを、広帯域 ラマン増幅用の励起用光源として用いることを特徴とするラマン増幅器。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

この発明は、ラマン増幅器などの励起用光源に適した半導体レーザ装置、半導体レーザモジュールおよびこれを用いたラマン増幅器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、インターネットをはじめとする様々なマルチメディアの普及に伴って、 光通信に対する大容量化の要求が大きくなっている。従来、光通信では、光ファ イバによる光の吸収が少ない波長である1310nmもしくは1550nmの帯 域において、それぞれ単一の波長による伝送が一般的であった。この方式では、 多くの情報を伝達するためには伝送経路に敷設する光ファイバの芯数を増やす必 要があり、伝送容量の増加に伴ってコストが増加するという問題点があった。

[0003]

そこで、高密度波長分割多重(DWDM:Dense-Wavelength Division Multip lexing)通信方式が用いられるようになった。このDWDM通信方式は、主にエルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA:Erbium Doped Fiber Amplifier)を用い、この動作帯域である1550nm帯において、複数の波長を使用して伝送を行う方式である。このDWDM通信方式あるいはWDM通信方式では、1本の光ファイバを用いて複数の異なる波長の光信号を同時に伝送することから、新たな線路を敷設する必要がなく、ネットワークの伝送容量の飛躍的な増加をもたらすことを可能としている。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

このEDFAを用いた一般的なWDM通信方式では、利得平坦化の容易な1550nmから実用化され、最近では、利得係数が小さいために利用されていなかった1580nm帯にまで拡大している。しかしながら、EDFAで増幅可能な帯域に比して光ファイバの低損失帯域の方が広いことから、EDFAの帯域外で

動作する光増幅器、すなわちラマン増幅器への関心が高まっている。

[0005]

ラマン増幅器は、エルビウムのような希土類イオンを媒体とした光増幅器がイオンのエネルギー準位によって利得波長帯が決まるのに対し、励起光の波長によって利得波長帯が決まるという特徴を持ち、励起光波長を選択することによって任意の波長帯を増幅することができる。

[0006]

ラマン増幅では、光ファイバに強い励起光を入射すると、誘導ラマン散乱によって、励起光波長から約100nm程度、長波長側に利得が現れ、この励起された状態の光ファイバに、この利得を有する波長帯域の信号光を入射すると、この信号光が増幅されるというものである。したがって、ラマン増幅器を用いたWDM通信方式では、EDFAを用いた通信方式に比して、信号光のチャネル数をさらに増加させることができる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、半導体レーザ素子は、温度変化などの様々に要因によって単位周波数当たりの光強度の揺らぎである相対強度雑音(RIN:Relative Intensity Noise)を発生する。ラマン増幅では、増幅の生じる過程が早く起こるため、励起光強度が揺らいでいると、ラマン利得も揺らぐことになり、このラマン利得の揺らぎがそのまま増幅された信号強度の揺らぎとして出力されてしまい、安定したラマン増幅を行わせることができないという問題点があった。

[0008]

ここで、ラマン増幅器としては、信号光の増幅媒体に対して後方から励起する 後方励起方式のほかに、信号光の増幅媒体に対して前方から励起する前方励起方 式および双方向から励起する双方向励起方式がある。現在、ラマン増幅器として 多用されているのは、後方励起方式である。その理由は、弱い信号光が強い励起 光とともに同方向に進行する前方励起方式では、励起光強度が揺らぐという問題 があるからである。したがって、前方励起方式にも適用できる安定した励起光源 の出現が要望されている。

[0009]

この発明は上記に鑑みてなされたもので、RINの値が小さい増幅信号光を得ることができる半導体レーザ装置、半導体レーザモジュールおよびこれを用いたラマン増幅器を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、請求項1にかかる半導体レーザ装置は、レーザ光の 出射端面に設けた第1反射膜と該レーザ光の反射端面に設けた第2反射膜との間 に形成された活性層を有し、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導 体レーザ装置において、前記活性層に注入されるバイアス電流を変調する変調信 号を生成し、該変調信号を前記バイアス電流に重畳する変調手段を備え、前記変 調手段は、前記レーザ光の変調によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以 下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

この請求項1の発明によれば、前記変調手段が、前記レーザ光の変調によって、たとえば変調度1%の変調を行って、レイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与え、伝送後のRINを低減するようにしている。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

また、請求項2にかかる半導体レーザ装置は、上記の発明において、前記変調 手段は、前記レーザ光の変調によってレイリー散乱レベルに1dB加えた値以下 の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

また、請求項3にかかる半導体レーザ装置は、前記活性層の近傍に回折格子を設け、前記活性層が形成する共振器長と該回折格子の波長選択特性とを含む発振パラメータの組み合わせ設定によって発振波長スペクトルの半値幅内に複数の発振縦モードを生成することを特徴とする。

[0014]

また、請求項4にかかる半導体レーザ装置は、レーザ光の出射端面に設けた第

1反射膜と該レーザ光の反射端面に設けた第2反射膜との間に形成された活性層を有し、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導体レーザ装置において、前記複数の発振縦モードの最大光強度に対する差分値が10dB以下である高出力発振縦モードを複数選択する回折格子を備え、前記回折格子は、前記高出力発振縦モードの選択本数によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする。

[0015]

この請求項4の発明によれば、前記回折格子による前記高出力発振縦モードの選択本数によって、たとえば高出力発振縦モードを18本以上とすることによって、レイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与え、伝送後のRINを低減するようにしている。

[0016]

また、請求項5にかかる半導体レーザ装置は、上記の発明において、前記回折格子は、前記高出力発振縦モードの選択本数によってレイリー散乱レベルに1d B加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

また、請求項6にかかる半導体レーザモジュールは、レーザ光の出射端面に設けた第1反射膜と該レーザ光の反射端面に設けた第2反射膜との間に形成された活性層を有し、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導体レーザ装置と、前記半導体レーザ装置から出射されたレーザ光を外部に導波する光ファイバと、前記半導体レーザ装置と前記光ファイバとの光結合効率が最大となる位置からずれた状態で前記半導体レーザ装置と前記光ファイバとの光結合を行う光結合レンズ系と、を備え、前記光結合効率の減衰によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする。

[0018]

この請求項6の発明によれば、光結合レンズ系が、前記半導体レーザ装置と前 記光ファイバとの光結合効率が最大となる位置からずれた状態で前記半導体レー ザ装置と前記光ファイバとの光結合を行い、前記光結合効率の減衰によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与え、伝送後のRINを低減するようにしている。

[0019]

また、請求項7にかかる半導体レーザモジュールは、レーザ光の出射端面に設けた第1反射膜と該レーザ光の反射端面に設けた第2反射膜との間に形成された活性層を有し、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導体レーザ装置と、前記半導体レーザ装置から出射されたレーザ光を外部に導波する光ファイバと、前記レーザ光を減衰させる光減衰器と、を備え、前記光減衰器の減衰によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする。

[0020]

この請求項7の発明によれば、前記光減衰器の減衰によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与え、伝送後のRINを低減するようにしている。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

また、請求項8にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記光結合効率または前記光減衰器の減衰によってレイリー散乱レベルに1dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることを特徴とする。

[0022]

また、請求項9にかかる半導体レーザモジュールは、上記の発明において、前記活性層の近傍に回折格子を設け、前記活性層が形成する共振器長と該回折格子の波長選択特性とを含む発振パラメータの組み合わせ設定によって発振波長スペクトルの半値幅内に複数の発振縦モードを生成することを特徴とする。

[0023]

また、請求項10にかかるラマン増幅器は、請求項1~5のいずれか一つに記載の半導体レーザ装置あるいは請求項6~9のいずれか一つに記載の半導体レーザモジュールを、広帯域ラマン増幅用の励起用光源として用いることを特徴とす

る。

[0024]

【発明の実施の形態】

以下に添付図面を参照して、この発明にかかる半導体レーザ装置、半導体レーザモジュールおよびこれを用いたラマン増幅器の好適な実施の形態について説明する。

[0025]

(実施の形態1)

まず、この発明の実施の形態1について説明する。この実施の形態1では、半導体レーザ装置へのバイアス電流を変調し、この変調されたレーザ光を出力するという、誘導ブリルアン散乱を抑制技術の一つを用いて、RINを抑制するというものである。本発明者らは、誘導ブリルアン散乱を抑制することによって、RINが低減されることをはじめてみいだした。なお、半導体レーザ装置をラマン増幅器などの分布型増幅器の励起用光源として用いる場合、ラマン増幅利得を大きくするために励起光出力を増大することが好ましいが、そのピーク値が高いと、誘導ブリルアン散乱が発生し、雑音が増加するという不具合が発生する。

[0026]

図1は、この発明の実施の形態1である半導体レーザ装置を斜めからみた破断図である。図2は、図1に示した半導体レーザ装置の長手方向の縦断面図である。また、図3は、図2に示した半導体レーザ装置のAーA線断面図である。図1~図3において、この半導体レーザ装置20は、n-InP基板1の(100)面上に、順次、n-InPによるバッファ層と下部クラッド層とを兼ねたn-InPによるバッファ層と下部クラッド層とを兼ねたn-InPによるバッファ層2、圧縮歪みをもつGRIN-SCH-MQW(Graded Index-Separate Confinement Heterostructure Multi Quantum Well)活性層3、p-InPのアスペーサ層4、p-InPクラッド層6、およびp-InG a As Pコンタクト層7が積層された構造を有する。

[0027]

p-InPスペーサ層 4 内には、膜厚 20nmを有し、出射側反射膜 15の反射端面から反射膜 14 側に向けて長さ $Lg=50\mu$ mの回折格子 13 が設けられ

、この回折格子13は、ピッチ約220nmで周期的に形成され、中心波長1.48μmのレーザ光を波長選択する。ここで、回折格子13は、回折格子の結合係数 κ と回折格子長Lgとの乗算値を0.3以下とすることによって、駆動電流一光出力特性の線形性を良好にし、光出力の安定性を高めている(特願2001-134545参照)。また、共振器長Lが1300μmの場合、回折格子長Lgが約300μm以下のときに複数の発振縦モード数で発振するので、回折格子長Lgは300μm以下とすることが好ましい。ところで、共振器長Lの長短に比例して、発振縦モード間隔も変化するため、回折格子長Lgは、共振器長Lに比例した値となる。すなわち、回折格子長Lg:共振器長L=300:1300の関係を維持するため、回折格子長Lgが300μm以下で複数の発振縦モードが得られる関係は、

 $L g \times (1 \ 3 \ 0 \ 0 \ (\mu m) / L) \le 3 \ 0 \ (\mu m)$

として拡張することができる。すなわち、回折格子長Lgは、共振器長Lとの比を保つように設定され、共振器長Lの(300/1300)倍の値以下としている(特願2001-134545参照)。この回折格子13を含むp-InPスペーサ層4、GRIN-SCH-MQW活性層3、およびn-InPバッファ層2の上部は、メサストライプ状に加工され、メサストライプの長手方向の両側には、電流ブロッキング層として形成されたp-InPブロッキング層8とn-InPブロッキング層9とによって埋め込まれている。また、p-InGaAsPコンタクト層7の上面には、p側電極10が形成される。一方、n-InP基板1の裏面には、n側電極11が形成される。なお、この半導体レーザ装置20から出力されたレーザ光は、単一横モード発振していればよく、活性層あるいは光導波路の構造はストライプ構造に限られない。

[0028]

半導体レーザ装置20の長手方向の一端面である光反射端面には、反射率80%以上、好ましくは98%以上の高光反射率をもつ反射膜14が形成され、他端面である光出射端面には、反射率が10%以下、好ましくは5%、1%、0.5%以下、さらに好ましくは0.1%以下の低光反射率をもつ出射側反射膜15が形成される。反射膜14と出射側反射膜15とによって形成された光共振器のG

RIN-SCH-MQW活性層 3 内に発生した光は、反射膜 1 4 によって反射し、出射側反射膜 1 5 を介し、レーザ光として出射されるが、この際、回折格子 1 3 によって波長選択されて出射される。

[0029]

また、この半導体レーザ装置 2 0 は、バイアス電流を p 側電極 1 0 に印加する電流駆動部 2 1 と、このバイアス電流を変調する変調周波数信号を印加する変調信号印加部 2 2 から出力された変調周波数信号は、接続点 2 3 においてバイアス電流に重畳され、この変調周波数信号が重畳された重畳信号は p 側電極 1 0 に印加されることになる。

[0030]

この変調周波数信号は、 $5\sim1000\,\mathrm{k}\,\mathrm{Hz}$ の正弦波信号であり、バイアス電流の値の $0.1\sim10\%$ 程度の振幅値を有する。すなわち、この変調周波数信号はバイアス電流の値の $\pm10\%$ まで変調される。なお、レーザ光の変調は、バイアス電流の値の $1\sim10\%$ 程度の振幅値に限らず、光出力の値の $1\sim10\%$ 程度の振幅値で変調するように定義してもよい。さらに、変調周波数信号は、正弦波信号に限らず、三角波信号などの周期信号であってもよい。この場合、三角波信号などの他の周期信号は複数の正弦波成分を含むため、正弦波信号を変調周波数信号とするのが好ましい。

[0031]

$$\Delta \lambda = \lambda 0^2 / (2 \cdot n \cdot L)$$

 0.1 nmとなる。すなわち、共振器長Lを長くすればするほど、縦モードのモード間隔 $\Delta \lambda$ は狭くなり、単一縦モードのレーザ光を発振するための選択条件が厳しくなる。

[0032]

一方、回折格子13は、そのブラッグ波長によって縦モードを選択する。この回折格子13による選択波長特性は、図4に示す発振波長スペクトル30として表される。

[0033]

図4に示すように、この実施の形態1では、回折格子13を有した半導体レーザ装置20による発振波長スペクトル30の半値幅 Δ λhで示される波長選択特性内に、発振縦モードを複数存在させるようにしている。従来のDBR(Distributed Bragg Reflector)半導体レーザ装置あるいはDFB(Distributed Feedback)半導体レーザ装置では、共振器長Lを800 μ m以上とすると、単一縦モード発振が困難であったため、かかる共振器長Lを有した半導体レーザ装置は用いられなかった。しかしながら、この実施の形態1の半導体レーザ装置20では、共振器長Lを積極的に800 μ m以上とすることによって、発振波長スペクトルの半値幅 Δ λh内に複数の発振縦モードを含ませてレーザ出力するようにしている。図4では、発振波長スペクトルの半値幅 Δ λh内に3つの発振縦モード31~33を有している。

[0034]

ところで、図4に示した各発振縦モード31a~31cのスペクトル幅は、電流駆動部21から出力されるバイアス電流のみによって駆動される場合に比して広くなっている。これは、変調信号印加部22から出力された変調周波数信号によって広げられたものである。図5は、バイアス電流に変調周波数信号が重畳された重畳信号によって駆動された場合における光出力の時間変化を示す図である。図5において、変調周波数信号は、バイアス電流の値の1%の振幅値を有する正弦波信号であり、バイアス電流のみによって駆動された場合の光出力の振幅を、正弦的に1%変化させている。この動作は、図6に示すように、半導体レーザ装置の電流一光出力(I-L)特性に変調をかけた場合に相当する。

[0035]

図6に示した変調領域では、I-L特性がリニアであるため、変調周波数信号によって変調された駆動電流の変調度がそのまま光出力の変調度となる。したがって、この変調領域においては、図7に示すように、変調周波数の振幅を1%に維持した駆動電流を印加するのみで、常に光出力の変調度は1%に維持され、光出力の変調度の制御が容易になる。一方、さらに光出力が増大する領域では、変調周波数信号によって変調された駆動電流の変調度と光出力の変調度とが一致しなくなる。この場合、変調周波数信号の振幅値を調整し、図5に示すように、常に光出力の変調度が1%になるように制御する。

[0036]

このようにして、半導体レーザ装置に印加される駆動電流の値が変化すると、 GRIN-SCH-MQW活性層 3 などのレーザ光の発光領域の実効屈折率 n が変化する。この実効屈折率 n が変化すると、光学的な共振器長 L op b 変化する。 すなわち、物理的な共振器長を「L」とすると、光学的な共振器長 L op b な

$Lop = n \cdot L$

で表され、実効屈折率 n の変化に追随して、光学的な共振器長 L opが変化する。 この光学的な共振器長 L opが変化すれば、ファブリペローモードでは、その共振 器波長も変化する。すなわち、その共振器波長も正弦的に変化することになる。

[0037]

このような電流変化に対応した波長変化は、結果的に発振縦モードのスペクトル幅を増大させることになる。図8は、変調周波数信号を重畳しないDFB型半導体レーザ装置の発振縦モードのスペクトル波形と、変調周波数信号が重畳されたこの実施の形態1である半導体レーザ装置の発振縦モードのスペクトル波形とを示す図である。図8(a)は、DFB型半導体レーザ装置に変調周波数信号を重畳しない場合における発振縦モードのスペクトル波形を示し、図8(b)は、変調周波数信号を重畳したこの実施の形態1である半導体レーザ装置の発振縦モードのスペクトル波形を示している。図8(b)に示した発振縦モードのスペクトル波形を示している。図8(b)に示した発振縦モードのスペクトル幅は、波長変化することによって広がり、しかも図4に示したように、複数の発振縦モードによってエネルギーが分散されるため、同じ光出力エネルギーを

得る場合(図8(a)と図8(b))、ピーク値が減少することになる。この結果、複数の発振縦モードの形成と変調周波数信号の重畳とによって、誘導ブリルアン散乱の閾値Pthを相対的に高くすることができる。

[0038]

一般に、図9に示すように、変調周波数信号の振幅値を増大すると、各発振縦モードのスペクトル幅は増大し、図10に示すように、スペクトル幅が増大すると、誘導ブリルアン散乱の閾値Pthは、光出力に対して増大する。したがって、誘導ブリルアン散乱を低減することができる安定した高い光出力の半導体レーザ装置を実現することができる。

[0039]

ここで、実施の形態1に示した半導体レーザ装置が誘導ブリルアン散乱を抑制し、結果的にRINを低減できることについて説明する。図11は、誘導ブリルアン散乱の発生の程度を検出するための測定装置の構造を示す模式図である。この測定装置では、カプラ31を介して一方に半導体レーザ装置20と反射光測定手段33とが配置され、他方に伝送用光ファイバ34と入力光測定手段35とが配置されている。また、一方と他方はカプラ31を介して互いに接続されており、伝送用光ファイバ34は、出力光測定手段36に接続されている。なお、伝送用光ファイバ34は、非ゼロ分散シフトファイバであるTrueWave-RS(R)であり、長さは37kmである。

[0040]

図11に示す測定装置において、入力光測定手段35には半導体レーザ装置20から出力されるレーザ光の強度と一定の比率を有する光が入射し、反射光測定手段33には伝送用光ファイバ34で散乱されて戻ってきた光の強度と一定の比率を有する光が入射する。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

ここで、誘導ブリルアン散乱が生じている場合、反射光測定手段33に入射する光の強度が増大する。そのため、半導体レーザ装置20から伝送用光ファイバ34に入射される光と、伝送用光ファイバ34で散乱されて戻ってきた光の強度との比(リターンロス)をとることで誘導ブリルアン散乱が生じているか否かの

判断ができる。一般に、光通信における励起光源として半導体レーザ装置を使用する場合には、リターンロスが-28dB~-30dB程度の値に抑制できれば、レイリー散乱によるバックグラウンドレベルと考えられ、誘導ブリルアン散乱が発生しておらず、励起光源としての使用に支障がないとされている。なお、このレイリー散乱のレベルは、伝送用光ファイバ34の種類などによって変化する値である。

[0042]

図12は、変調度に対するリターンロスの関係の示す図である。図12において、レイリー散乱のレベルは、約-30dBであり、変調度を増加していくに従い、リターンロスが減少し、最終的にはレイリー散乱のレベル以下となり、レイリー散乱のレベルが支配する。図12では、変調度なし(0%)のときにリターンロスは-10.0dBであったが、変調度を0.5%にするとリターンロスは-26.8dBまで減少し、変調度が1%になった段階でリターンロスは、ほぼレイリー散乱のレベルと同じ-29.4dBとなり、誘導ブリルアン散乱の影響を全く受けなくなる。さらに変調度を5%にすると、リターンロスは-29.7dBであり、この場合においても誘導ブリルアン散乱の影響を受けなくなる。

[0043]

ここで、伝送用光ファイバ34の出力端、すなわち出力光測定手段36側においてRINの測定を行うと、図13に示すような結果が得られた。図13は、変調度を変化させた場合のRINの周波数特性を示している。なお、この場合における半導体レーザ装置の駆動電流Iは900mAであり、波長中心 λ centerは1428nmであり、ピークから10dBダウンの波長幅 Δ λ 10dBは2.2nmであり、上述したように伝送用光ファイバ長Lは37kmである。図13において、無変調の場合、データL1に示すように、低周波領域で大きなRINを呈する。すなわち、1GHzから0.1GHzにかけて急激にRINが増大し、やくー100dB程度のRINが0Hz近傍まで存在する。

[0044]

ここで、変調度を増加させ、リターンロスを減少させると、低周波領域のRINが順次減少する。変調度を0.2%(リターンロス=-15dB)にすると、

データL2に示すように、低周波領域のRINはやや減少して一105dB程度になる。さらに、変調度を0.5%(リターンロス=-27dB)にすると、データL3に示すように、急激に低周波領域のRINが減少し、-135dB程度になる。さらに、変調度を1%(リターンロス=-29dB)にすると、データL4に示すように、低周波領域のRINがさらに減少し、-140dB程度になる。さらに、変調度を5%(リターンロス=—30dB)にすると、データL5に示すように、低周波領域のRINがさらに減少し、-145dB程度となり、低周波領域では、測定前におけるデータL0とほぼ同じRINの値になる。しかも、このとき測定前のRINは、約0.1GHz近傍で突起形状をなして、RINが増大しているが、変調することによって、この突起形状をもなくした低い値のRINを得ることができる。

[0045]

また、このことは、図14に示すように、リターンロスを減少させ、誘導ブリルアン散乱を抑制することによって、RINを減少させることができることを意味する。この点に関しては、後述する実施の形態についても同様であって、図13に示す結果を得ることができた。この場合、レイリー散乱のレベルの+2dB程度大きい値のリターンロスのレベルを、誘導ブリルアン散乱が抑制されるしきい値とすることが好ましく、さらにレイリー散乱のレベルの+1dB程度大きい値のリターンロスのレベルを、誘導ブリルアン散乱が抑制されるしきい値とすることがより好ましい。

[0046]

(実施の形態2)

つぎに、この発明の実施の形態2について説明する。上述した実施の形態1では、レーザ光を変調することによって誘導ブリルアン散乱を抑制し、結果としてRINを低減するというものであったが、この実施の形態2では、半導体レーザ装置のモード本数を増大させることによって誘導ブリルアン散乱を抑制し、RINを低減しようとするものである。

[0047]

この実施の形態2の半導体レーザ装置は、実施の形態1に示した半導体レーザ

装置 20 と同じ構成である。ただし、変調信号印加部 22 によるレーザ光の変調は行わない。図 15 に示すように、この実施の形態 2 では、回折格子 13 を有した半導体レーザ装置による発振波長スペクトル 46 の半値幅 $\Delta\lambda$ h で示される波長選択特性内に、発振縦モードを複数存在させるようにしている。従来の DBR(Distributed Bragg Reflector)半導体レーザ装置あるいは DFB(Distributed Feedback)半導体レーザ装置では、共振器長 L を 800μ m以上とすると、単一発振縦モード発振が困難であったため、かかる共振器長 L を有した半導体レーザ装置は用いられなかった。しかしながら、この実施の形態 200μ m以上とすることによって、発振波長スペクトル 460μ に 800μ m以上とする

[0048]

つぎに、回折格子 13 によって選択される発振縦モードについて、最大強度との差分値が 10 d B以下である発振縦モードの本数と、発振波長スペクトル 46 の R M S 法によるスペクトル幅 $\Delta \lambda$ RMSがどのようにして決定されるかについて説明する。基本的には、最大強度との差分値が 10 d B以下である発振縦モードの本数と、R M S 法のスペクトル幅 $\Delta \lambda$ RMSは主として回折格子 13 の構造によって決定される。

[0049]

まず、回折格子13の回折格子長Lgあるいは結合係数 κ を変化させる構造が挙げられる。一般に、回折格子長Lgが減少するにつれて、発振波長スペクトルの半値幅 Δ λ h は広くなり、スペクトル幅 Δ λ RMSも増大する。そして、最大強度との差分値が10 d B以下である発振縦モードの本数も増大する。所望の発振縦モードを選択するためには、結合係数 κ と回折格子長Lgとの積 κ ・Lgは一定以上の値を有する必要があるものの、その条件下で回折格子長Lgの値を減少させることで、発振縦モードの本数を増大させ、スペクトル幅 Δ λ RMSを広くすることができる。

[0050]

また、回折格子13のグレーティング周期を変化させることも有効である。図

[0051]

図16に示すように、回折格子13は、平均周期が220nmであり、±0.02nmの周期揺らぎ(偏差)を周期Cで繰り返す構造を有している。この±0.02nmの周期揺らぎによって回折格子13の反射帯域は、約2nmの半値幅を有し、これによって、最大強度との差分値が10dB以下である発振縦モードの本数を増大させることができる。

[0052]

[0053]

さらに、図18(a)に示すように、周期 Λ_1 と周期 Λ_2 とを1回ずつ交互に繰り返す回折格子として、周期揺らぎを持たせるようにしてもよい。また、図18(b)に示すように、周期 Λ_3 と周期 Λ_4 とをそれぞれ複数回、交互に繰り返す回折格子として、周期揺らぎを持たせるようにしてもよい。さらに、図18(c)に示すように、連続する複数回の周期 Λ_5 と連続する複数回の周期 Λ_6 とをもつ回折格子として、周期揺らぎを持たせるようにしてもよい。また、周期 Λ_1 、 Λ_3 、 Λ_5 と周期 Λ_2 、 Λ_4 、 Λ_6 との間の離散的な異なる値をもつ周期をそれぞれ補完して配置するようにしてもよい。

[0054]

[0055]

図20は、回折格子13が図21とは異なる構造を有する半導体レーザ装置の発振波形を示すグラフである。最大強度を有する発振縦モードは1459.5 n m付近に存在し、その光強度は約-18dBである。そして、最大強度との差分値が10dB以下、すなわち図20のグラフにおいて約-28dB以上の光強度を有する発振縦モードの本数は20本となる。

[0056]

なお、比較例として図21に10本未満の発振縦モードを有する半導体レーザ・装置の発振波形を示す。図21において最大強度を有する発振縦モードは1429nm付近に存在し、その光強度は約-10dBである。したがって、最大強度との差分値が10dB以下、すなわち図21のグラフにおいて-20dB以上の光強度を有する発振縦モードの本数は6本となる。

[0057]

つぎに、発振縦モードの最大光強度に対する差分値が10dB以下となる発振縦モードの本数および発振波長スペクトルのRMS法のスペクトル幅と、誘導ブリルアン散乱との相関関係を調べ、この実施の形態2の半導体レーザ装置が誘導ブリルアン散乱の発生を抑制でき、RINを低減できることを示す。具体的には、図11に示した測定装置を用いて複数の半導体レーザ装置についてリターンロスの測定をおこなっている。

[0058]

ここで、複数の半導体レーザ装置 $A \sim G$ について、半導体レーザ装置の温度を変化させてリターンロスの測定をおこなった。なお、半導体レーザ装置の温度はそれぞれ5 $^\circ$ 、 15° 、 25° 、 35° 、 45° に変化させた上で測定をおこなっている。図22は、この測定における最大強度との差分値が10 d B以下である発振縦モードの本数とリターンロスとの関係を示す図である。なお、同一半導体レーザ装置について発振縦モードの本数が変化しているのは温度変化の影響によるものである。半導体レーザ装置の温度は発振縦モードの本数に影響を与えるものの、リターンロスとの直接的な関係においては温度変化による影響はほとんどない。具体的には、いずれの温度であっても最大強度との差分値が10 d B以下である発振縦モードの本数が10 本以上であればリターンロスは10 d B以りも低い値となり、発振縦モードの本数が10 を以上であればリターンロスは10 d B以下の値となる。

[0059]

ここで、図22では、レイリー散乱のレベルは、-28dBである。したがって、発振縦モードが18本以上であれば、誘導ブリルアン散乱を抑制することができ、図13に示したリターンロスに対応してRINを低減できる。この場合、実施の形態1と同様に、レイリー散乱のレベルの+2dB程度大きい値のリターンロスのレベルを、誘導ブリルアン散乱が抑制されるしきい値とすることが好ましく、さらにレイリー散乱のレベルの+1dB程度大きい値のリターンロスのレベルを、誘導ブリルアン散乱が抑制されるしきい値とすることがより好ましい。

[0060]

(実施の形態3)

つぎに、この発明の実施の形態3について説明する。上述した実施の形態1では、レーザ光を変調することによって誘導ブリルアン散乱を抑制してRINを低減するようにし、また実施の形態2では、モード本数を増大させて誘導ブリルアン散乱を抑制してRINを低減するようにしていたが、この実施の形態3では、半導体レーザ装置から出力されたレーザ光を減衰させることによって誘導ブリルアン散乱を抑制し、結果的にRINを低減しようとするものである。

[0061]

図23は、実施の形態3にかかる半導体レーザモジュールの構成を示す縦断面図である。図23において、この半導体レーザモジュール50は、半導体レーザ装置20に対応する半導体レーザ装置51を有する。半導体レーザモジュール50の筐体として、Cu-W合金などによって形成されたパッケージ59の内部底面上に、温度制御装置としてのペルチェモジュール58が配置される。ペルチェモジュール58上にはベース57が配置され、このベース57上にはヒートシンク57aが配置される。

[0062]

ペルチェモジュール 5 8 には、図示しない電流が与えられ、その極性によって 冷却および加熱を行なうが、半導体レーザ装置 5 1 の温度上昇による発振波長ず れを防止するため、主として冷却器として機能する。すなわち、ペルチェモジュ ール 5 8 は、レーザ光が所望の波長に比して長い波長である場合には、冷却して 低い温度に制御し、レーザ光が所望の波長に比して短い波長である場合には、加 熱して高い温度に制御する。この温度制御は、具体的に、ヒートシンク 5 7 a 上 であって、半導体レーザ装置 5 1 の近傍に配置されたサーミスタ 5 8 a の検出値 をもとに制御され、図示しない制御装置は、通常、ヒートシンク 5 7 a の温度が 一定に保たれるようにペルチェモジュール 5 8 を制御する。

[0063]

また、図示しない制御装置は、半導体レーザ装置51の駆動電流を上昇させるに従って、ヒートシンク57aの温度が下がるようにペルチェモジュール58を制御する。このような温度制御を行なうことによって、半導体レーザ装置51の波長安定性を向上させることができ、歩留まりの向上にも有効となる。なお、ヒートシンク57aは、例えばダイヤモンドなどの高熱伝導率をもつ材質によって形成することが望ましい。これは、ヒートシンク57aがダイヤモンドで形成されると、高電流注入時の発熱が抑制されるからである。この場合、波長安定性がさらに向上し、しかも温度制御も容易になる。

[0064]

ベース57上には、半導体レーザ装置51およびサーミスタ58aを配置した ヒートシンク57a、第1レンズ52、およびモニタフォトダイオード56が配 置される。半導体レーザ装置 5 1 から出射されたレーザ光は、第 1 レンズ 5 2 、アイソレータ 5 3 、および第 2 レンズ 5 4 を介し、光ファイバ 5 5 上に導波される。なお、モニタフォトダイオード 5 6 は、半導体レーザ装置 5 1 の反射膜側から漏れた光をモニタ検出する。

[0065]

ここで特に、この実施の形態3にかかる半導体レーザモジュールの特徴となる点は、第2レンズ54の光学中心が、第1レンズ52およびアイソレータ53を介して半導体レーザ装置51から出射されたレーザ光の光軸に対して、図示する矢印X,Y,Zのいずれかの方向にずれていることである。ここで、X方向は、半導体レーザモジュール50の高さ方向(紙面上下方向)を指し、Y方向は、半導体レーザモジュール50の幅方向(紙面垂直方向)を指し、Z方向は、半導体レーザモジュール50の長手方向(紙面左右方向)を指す。すなわち、この半導体レーザモジュール50は、いわゆるデフォーカスを意図的に行なっている。換言すれば、第2レンズ54と光ファイバ55との光結合効率を意図的に小さくしている。なお、結合の信頼の観点から、結合ずれに対するトレランスはZ方向の方が大きいため、その方向にずらすのがより好ましい。

$[0\ 0\ 6\ 6]$

このデフォーカスによって、半導体レーザ装置 5 1 に十分に大きな駆動電流が 印加された状態であっても、第 2 レンズ 5 4 と光結合される光ファイバ 5 5 には 、半導体レーザ装置 5 1 が出射するレーザ光の強度よりも小さな強度のレーザ光 が伝播する。

[0067]

よって、この半導体レーザモジュールは、半導体レーザ装置51の駆動電流を大きくした状態で、レーザ光としては強度の小さなものを出力することができることになる。これは、上述したように、前方励起方式の励起光源として用いられる最適な条件、すなわち、駆動電流を大きくしてRINの悪化を防ぎつつ、小さな強度の励起光が得られるという条件を満たす。

[0068]

ここで、図24は、デフォーカスによる減衰率に対応したリターンロスとの関

係を示している。リターンロスは、図11に示した測定装置を用いて測定している。また、減衰率は、減衰がない場合のリターンロスー11dBを基準にした値である。図24に示すように、減衰率が-3dB以上となった場合にリターンロスは-28dB以下となり、誘導ブリルアン散乱が抑制される。ここで、レイリー散乱のレベルは-30dBである。

[0069]

すなわち、この実施の形態3においても、デフォーカスによる減衰率の増大によって、実施の形態1,2と同様に、リターンロスが減少し、誘導ブリルアン散乱を抑制し、結果的に図13に示すようにリターンロスに対応したRINの低減を図ることができる。この場合、実施の形態1,2と同様に、レイリー散乱のレベルの+2dB程度大きい値のリターンロスのレベルを、誘導ブリルアン散乱が抑制されるしきい値とすることが好ましく、さらにレイリー散乱のレベルの+1dB程度大きい値のリターンロスのレベルを、誘導ブリルアン散乱が抑制されるしきい値とすることがより好ましい。

[0070]

なお、光結合効率の意図的な低下は、上記した第2レンズ54に限らず、モジュール内の他の光学系レンズや光学部品の配置を調節することによっても可能である。

[0071]

(実施の形態4)

つぎに、この発明の実施の形態4について説明する。上述した実施の形態3に 示した半導体レーザモジュールでは、意図的にデフォーカスを行なうことで、レ ーザ光の強度を小さくするとしたが、この実施の形態4では、デフォーカスを行 なわずに、半導体レーザモジュールの出力端部または光ファイバを介した半導体 レーザモジュールの出力端近傍に、光減衰器を設けるようにしている。

[0072]

図25は、この発明の実施の形態4である半導体レーザモジュールの概略構成を示すブロック図である。図25において、デフォーカスを行なわない半導体レーザモジュール50aは、ぞの出力端を光ファイバ55aの一端に接続し、光フ

ァイバ55aの他端は、光減衰器(光アッテネータ)50bの入力端に接続され、光減衰器50bの出力端は、光ファイバ55bの一端に接続される。

[0073]

すなわち、半導体レーザモジュール50 a から出力されたレーザ光の出力パワーは、光減衰器50 b において減衰され、減衰された結果がラマン増幅器の励起光として寄与する。

[0074]

この実施の形態4においても、減衰率の増大によって、実施の形態1~3と同様に、リターンロスが減少し、誘導ブリルアン散乱を抑制し、結果的に図13に示すようにリターンロスに対応したRINの低減を図ることができる。この場合、実施の形態1~3と同様に、レイリー散乱のレベルの+2dB程度大きい値のリターンロスのレベルを、誘導ブリルアン散乱が抑制されるしきい値とすることが好ましく、さらにレイリー散乱のレベルの+1dB程度大きい値のリターンロスのレベルを、誘導ブリルアン散乱が抑制されるしきい値とすることがより好ましい。

[0075]

この実施の形態4では、レーザの結合状態を従来と変えないままで、最終的な 出力を光減衰器で落とすため、実施の形態3と同様な効果を享受することができ るとともに、半導体レーザを発振するモジュール部分を共有化できる。

[0076]

(実施の形態 5)

次に、この発明の実施の形態5について説明する。この実施の形態5では、上述した実施の形態1,2に示した半導体レーザ装置をモジュール化した半導体レーザモジュールあるいは実施の形態3,4に示した半導体レーザモジュールをラマン増幅器に適用したものである。

[0077]

図26は、前方励起方式を採用したラマン増幅器の構成を示すブロック図である。図26において、アイソレータ63の近傍に設けられたWDMカプラ65′には、上述した実施の形態1,2に示した半導体レーザ装置をモジュール化した

半導体レーザモジュールあるいは実施の形態 3 、4 に示した半導体レーザモジュールに対応する半導体レーザモジュール 6 0 a $^{'}\sim 6$ 0 d $^{'}$ 、偏波合成カプラ 6 1 a $^{'}$ 、6 1 b $^{'}$ およびWDMカプラ 6 2 $^{'}$ を有した回路が接続され、WDMカプラ 6 2 $^{'}$ から出力される励起光を信号光と同じ方向に出力する前方励起を行なう。この場合、半導体レーザモジュール 6 0 a $^{'}\sim 6$ 0 d $^{'}$ は、上述した実施の形態 1 、2 に示した半導体レーザ装置をモジュール化した半導体レーザモジュールあるいは実施の形態 3 、4 に示した半導体レーザモジュールに対応した半導体レーザモジュールを用いているため、結果的に R I N が低減された状態で前方励起を効果的に行なうことができる。

[0078]

また、図27は、双方向励起方式を採用したらラマン増幅器の構成を示すブロック図である。なお、図27において、図26と共通する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。図27に示したラマン増幅器は、図26に示したラマン増幅器の構成に、WDMカプラ62、半導体レーザモジュール60a~60dおよび偏波合成カプラ61a,61bをさらに設け、後方励起と前方励起とを行なう。但し、後方励起を行なうための半導体レーザモジュール60a~60dについては、特に上述した実施の形態1~4に示した半導体レーザ装置あるいは半導体レーザモジュールを用いなくてもよい。

[0079]

各半導体レーザモジュール60a,60bは、偏波面保持ファイバ71を介して、複数の発振縦モードを有するレーザ光を偏波合成カプラ61aに出力し、各半導体レーザモジュール60c,60dは、偏波面保持ファイバ71を介して、複数の発振縦モードを有するレーザ光を偏波合成カプラ61bに出力する。ここで、半導体レーザモジュール60a,60bが発振するレーザ光は、同一波長である。また、半導体レーザモジュール60c,60dが発振するレーザ光は、同一波長であるが半導体レーザモジュール60a,60bが発振するレーザ光の波長とは異なる。これは、ラマン増幅が偏波依存性を有するためであり、偏波合成カプラ61a,61bによって偏波依存性が解消されたレーザ光として出力するようにしている。

[0080]

各偏波合成カプラ61a,61bから出力された異なる波長をもったレーザ光は、WDMカプラ62によって合成され、合成されたレーザ光は、WDMカプラ65を介してラマン増幅用の励起光として増幅用ファイバ64に出力される。この励起光が入力された増幅用ファイバ64には、増幅対象の信号光が入力され、ラマン増幅される。

[0081]

この双方向励起方式の場合にも、半導体レーザモジュール60 a ~ ~ 60 d ~ は、上述した実施の形態1で説明した半導体レーザ装置を用いているため、結果的にRINが低減された状態で前方励起を効果的に行なうことができる。

[0082]

上述した図26または図27に示したラマン増幅器は、上述したようにWDM通信システムに適用することができる。図28は、図26または図27に示したラマン増幅器を適用したWDM通信システムの概要構成を示すブロック図である。

[0083]

図28において、複数の送信機 $T \times 1 \sim T \times n$ から送出された波長 $\lambda 1 \sim \lambda n$ の光信号は、光合波器80によって合波され、1つの光ファイバ85に集約される。この光ファイバ85の伝送路上には、図26または図27に示したラマン増幅器に対応した複数のラマン増幅器81,83が距離に応じて配置され、減衰した光信号を増幅する。この光ファイバ85上を伝送した信号は、光分波器84によって、複数の波長 $\lambda 1 \sim \lambda n$ の光信号に分波され、複数の受信機 $R \times 1 \sim R \times n$ に受信される。なお、光ファイバ85上には、任意の波長の光信号を付加し、取り出したりするADM(Add/Drop Multiplexer)が挿入される場合もある。

[0084]

なお、上述した実施の形態5では、実施の形態1,2に示した半導体レーザ装置あるいは実施の形態3,4に示した半導体レーザモジュールを、ラマン増幅用の励起光源に用いる場合を示したが、これに限らず、たとえば、980nm,1480nmなどのEDFA励起用光源として用いることができるのは明らかであ

る。

[0085]

なお、上述した実施の形態では、活性層近傍の一部領域に回折格子13を設け、あるいは活性層近傍の全領域に揺らぎをもった回折格子を設け、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導体レーザ装置をもとに説明したが、これに限らず、マルチモードレーザであればよく、たとえば、ファブリペロ型レーザであってもよい。また、実施の形態2を除き、DFBレーザなどのシングルモードレーザにも適用することは可能である。

[0086]

【発明の効果】

以上説明したように、この発明によれば、前記変調手段が、前記レーザ光の変調によって、たとえば変調度1%の変調を行って、レイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与え、または回折格子による前記高出力発振縦モードの選択本数によって、たとえば高出力発振縦モードを18本以上とすることによって、レイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与え、または、光結合レンズ系が、前記半導体レーザ装置と前記光ファイバとの光結合効率が最大となる位置からずれた状態で前記半導体レーザ装置と前記光ファイバとの光結合を行い、前記光結合効率の減衰によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与え、または、光減衰器の減衰によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与えることによって、伝送後のRINを低減することができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の実施の形態 1 である半導体レーザ装置を斜めからみた破断図である

【図2】

この発明の実施の形態1である半導体レーザ装置の構成を示す長手方向の縦断

面図である。

【図3】

図2に示した半導体レーザ装置のA-A線断面図である。

【図4】

図1に示した半導体レーザ装置の発振波長スペクトルと発振縦モードとの関係 を示す図である。

【図5】

バイアス電流に変調周波数信号を重畳した場合における光出力の時間変化を示す図である。

[図6]

電流-光出力特性を用いて重畳信号が印加された場合における光出力変化を示す図である。

【図7】

バイアス電流に変調周波数信号を重畳した場合における駆動電流の時間変化を 示す図である。

【図8】

重畳信号が印加され、かつ共振器長に対して部分的に回折格子が設けられた場合に誘導ブリルアン散乱の閾値が相対的に上昇することを示す図である。

【図9】

重畳信号を印加した場合における変調周波数信号振幅に対する発振縦モードの スペクトル幅の変化を示す図である。

【図10】

発振縦モードのスペクトル幅に対する誘導ブリルアン散乱の閾値の変化を示す 図である。

【図11】

誘導ブリルアン散乱の発生の程度の検出およびRINの測定をするための測定装置の構成を示す模式図である。

【図12】

この発明の実施の形態1における変調度に対するリターンロスの関係を示す図

である。

【図13】

この発明の実施の形態1における変調度あるいはリターンロスをパラメータとしてRINの周波数特性を示す図である。

【図14】

RINのリターンロス依存性を示す図である。

【図15】

この発明の実施の形態2である半導体レーザ装置の発振波形を示す模式図である。

【図16】

この発明の実施の形態2における回折格子の構造の一例を示す図である。

【図17】

この発明の実施の形態2である半導体レーザ装置の発振波形を示す模式図である。

【図18】

この発明の実施の形態2における回折格子の構造の他の一例を示す図である。

【図19】

発振縦モードの最大強度に対する差分値が10dB以下となる発振縦モードの本数が14本となる半導体レーザ装置の発振波形を示す図である。

【図20】

発振縦モードの最大強度に対する差分値が10dB以下となる発振縦モードの本数が20本となる半導体レーザ装置の発振波形を示す図である。

【図21】

発振縦モードの最大強度に対する差分値が10dB以下となる発振縦モードの本数が6本となる半導体レーザ装置の発振波形を示す図である。

【図22】

半導体レーザ装置の温度を変化させた場合の発振縦モードの最大強度に対する 差分値が10dB以下となる発振縦モードの本数とリターンロスとの関係を示す 図である。

【図23】

この発明の実施の形態3である半導体レーザモジュールの構成を示す縦断面図である。

【図24】

デフォーカスによる減衰率とリターンロスとの関係を示す図である。

【図25】

この発明の実施の形態 4 である半導体レーザモジュールの概要構成を示す図である。

【図26】

前方励起方式を採用したラマン増幅器の構成を示すブロック図である。

【図27】

双方向励起方式を採用したラマン増幅器の構成を示すブロック図である。

【図28】

図26または図37に示したラマン増幅器を用いたWDM通信システムの概要構成を示すブロック図である。

【符号の説明】

- 1 n-InP基板
- 2 n-Inpバッファ層
- 3 GRIN-SCH-MQW活性層
- 4 p-InPスペーサ層
- 6 p-InPクラッド層
- 7 p-InGaAsPコンタクト層
- 8 p-InPブロッキング層
- 9 n-InPブロッキング層
- 10 p側電極
- 11 n 側電極
- 13 回折格子
- 14 反射膜
- 15 出射側反射膜

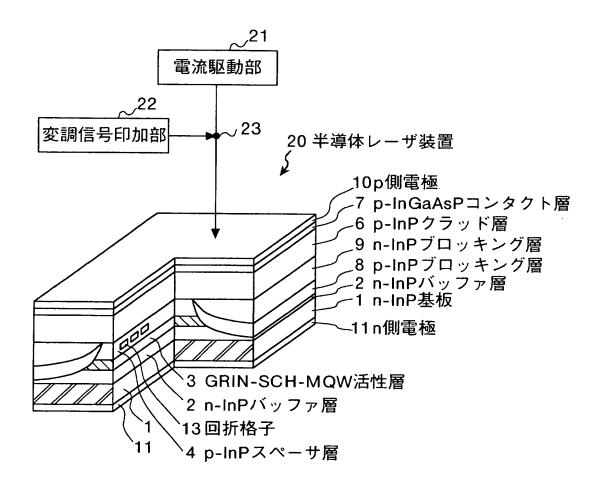
- 20 半導体レーザ装置
- 21 電流駆動部
- 22 変調信号印加部
- 2 3 接続点
- 30,46 発振波長スペクトル
- 31a~31c, 47~49 発振縦モード
- 31 カプラ
- 33 反射光測定手段
- 34 伝送用光ファイバ
- 35 入力光測定手段
- 36 出力光測定手段
- 45 複合発振波長スペクトル
- 50,60a~60d,60a~~60d~ 半導体レーザモジュール
- 50a 光減衰器
- 52 第1レンズ
- 53, 63, 66 アイソレータ
- 54 第2レンズ
- 55 光ファイバ
- 56 モニタフォトダイオード
- 57 ベース
- 57a ヒートシンク
- 58 ペルチェモジュール
- 58a サーミスタ
- 59 パッケージ
- 61a, 61b, 61a´, 61b´ 偏波合成カプラ
- 62, 65, 62´, 65´ WDMカプラ
- 64 増幅用ファイバ
- 67 モニタ光分配用カプラ
- 68 制御回路

- 69 信号光入力ファイバ
- 70 信号光出力ファイバ
- 71 偏波面保持ファイバ
- 81,83 ラマン増幅器

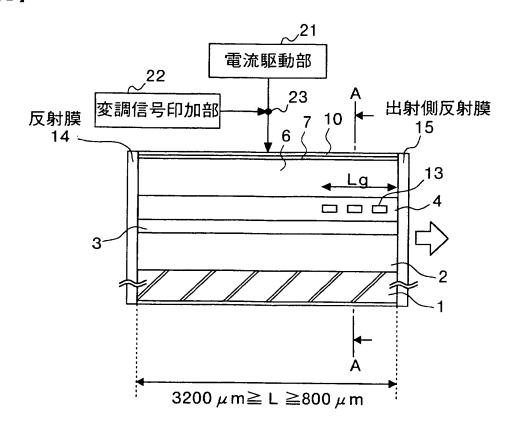
【書類名】

図面

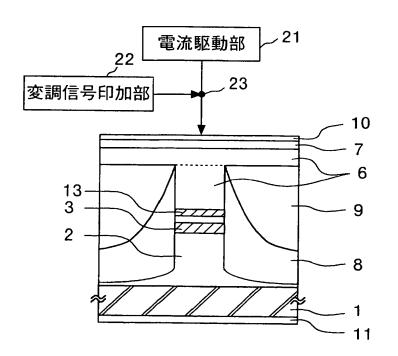
図1】



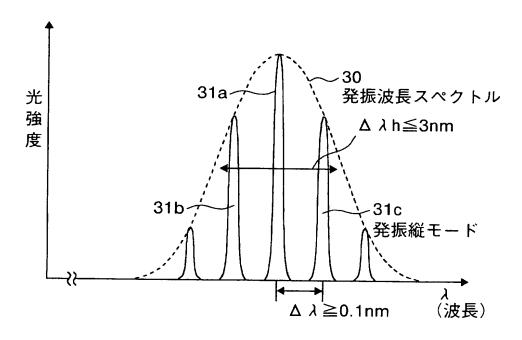
【図2】



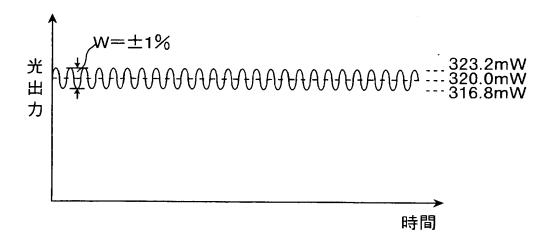
【図3】



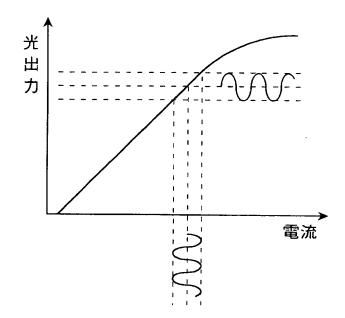
【図4】



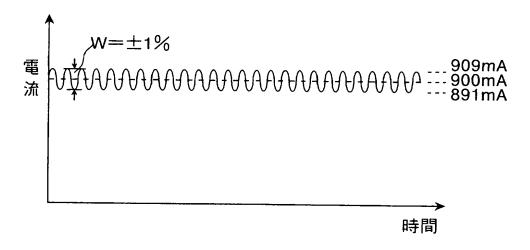
【図5】



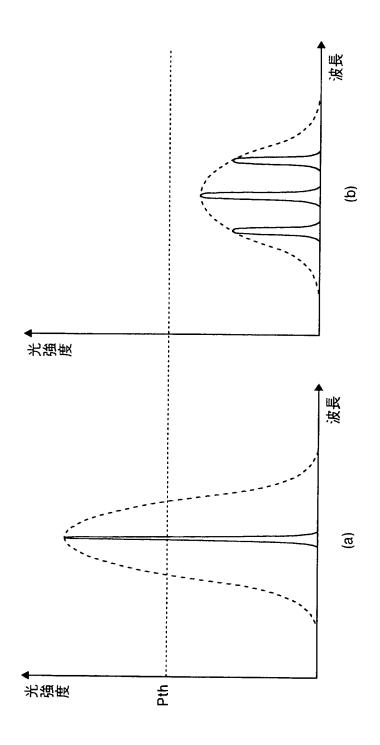
【図6】



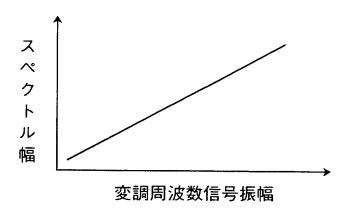
【図7】



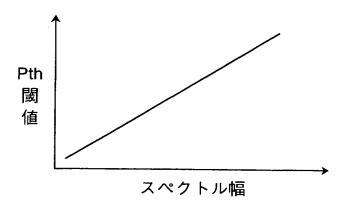
【図8】



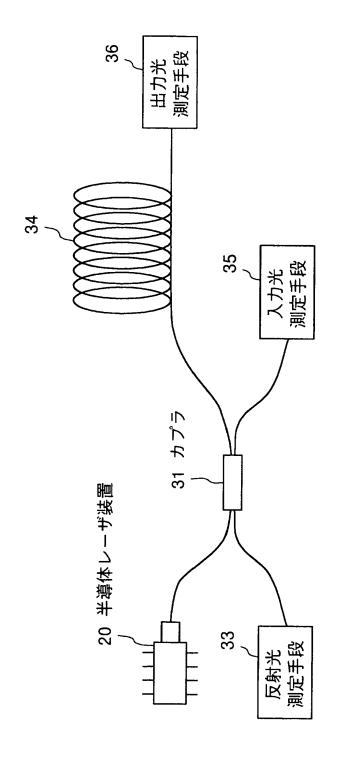
【図9】



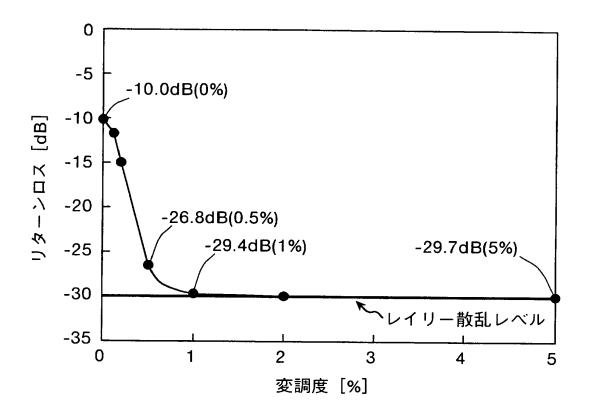
【図10】



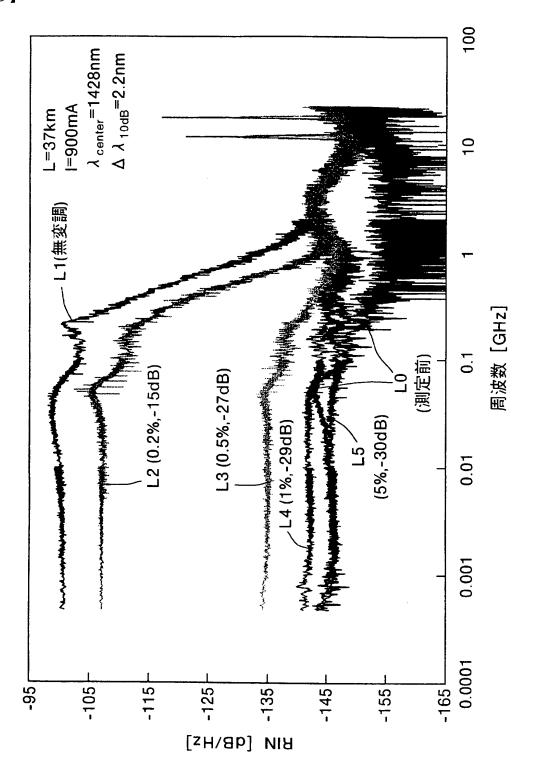
【図11】



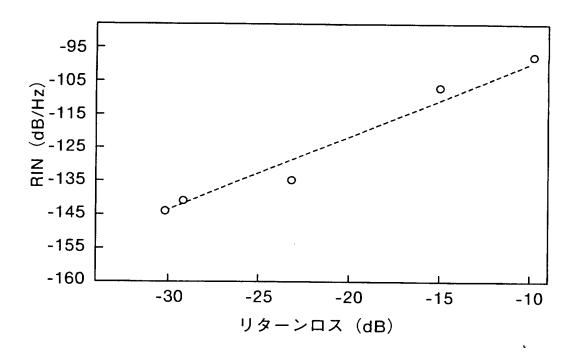
【図12】



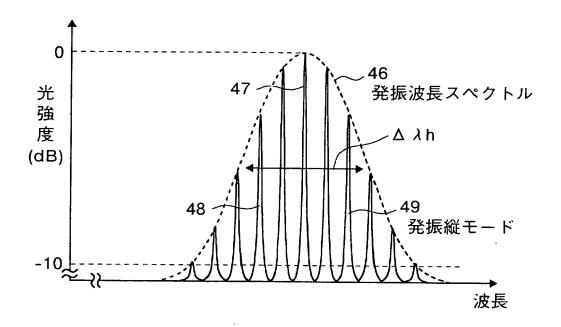
[図13]



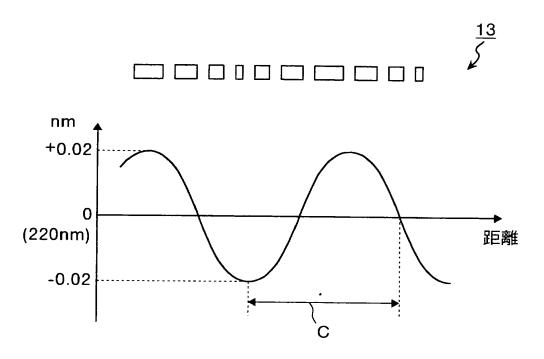
【図14】



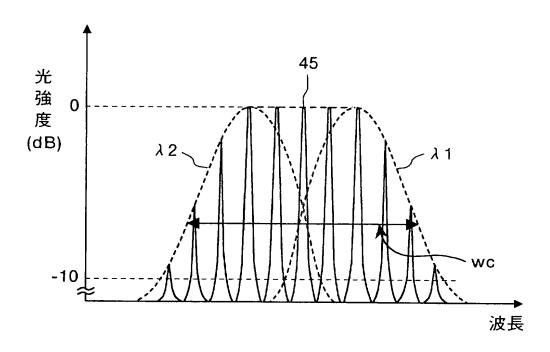
【図15】



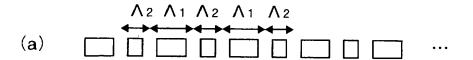
【図16】



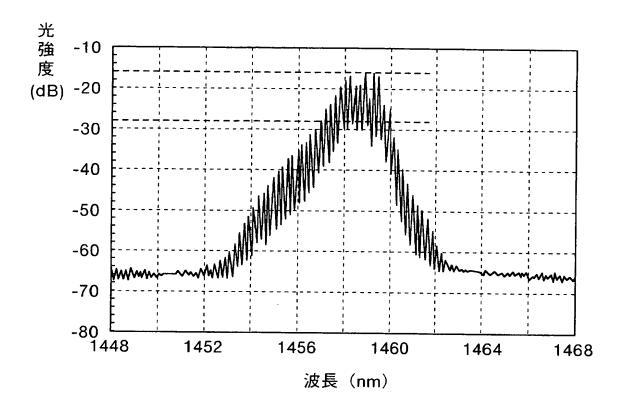
【図17】



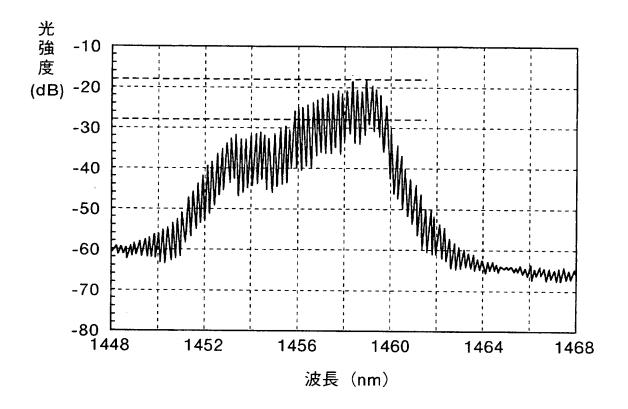
【図18】



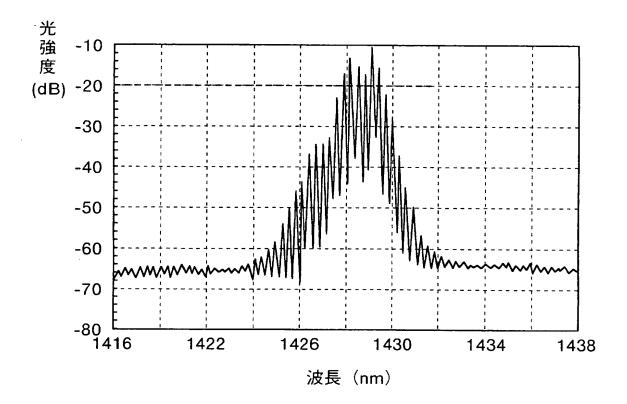
【図19】



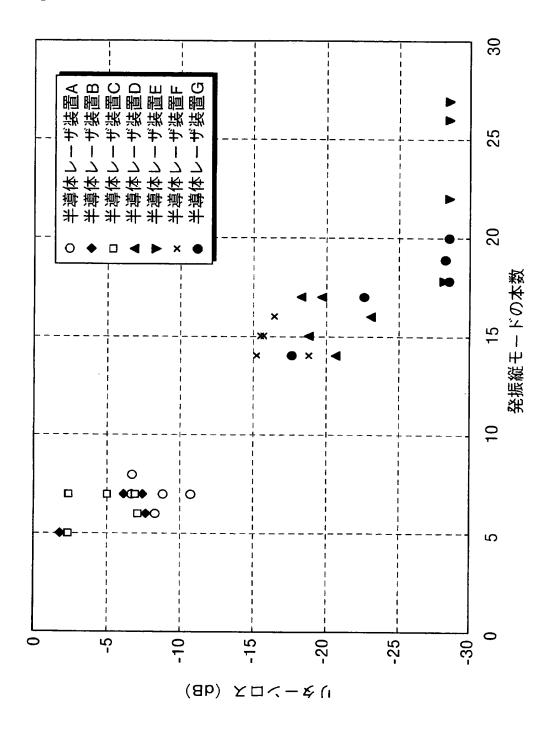
【図20】



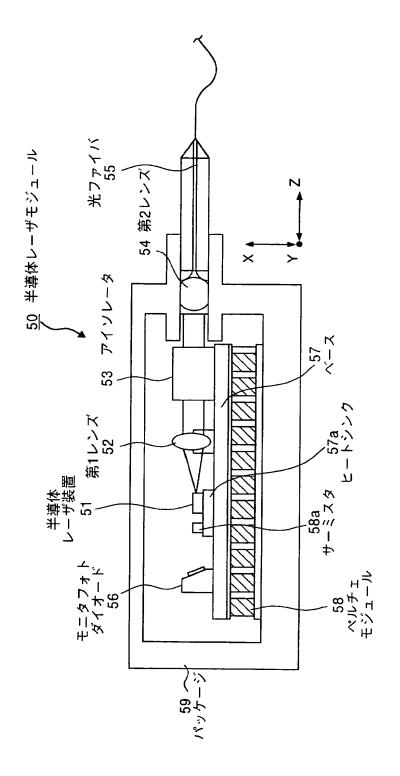
【図21】



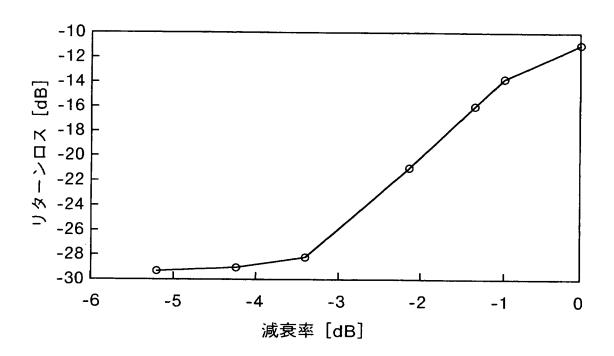
【図22】



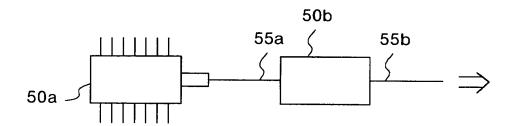
【図23】



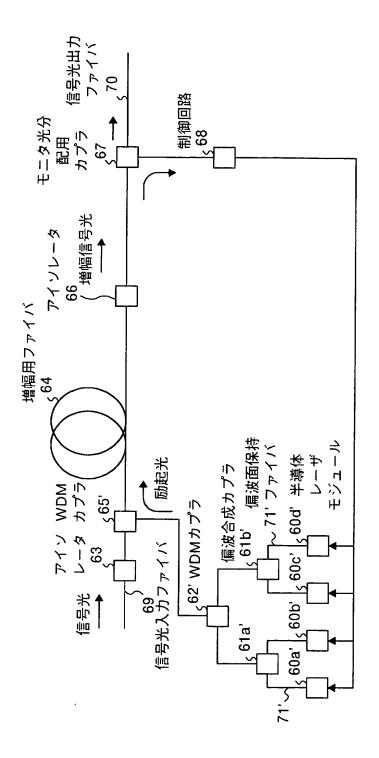
【図24】



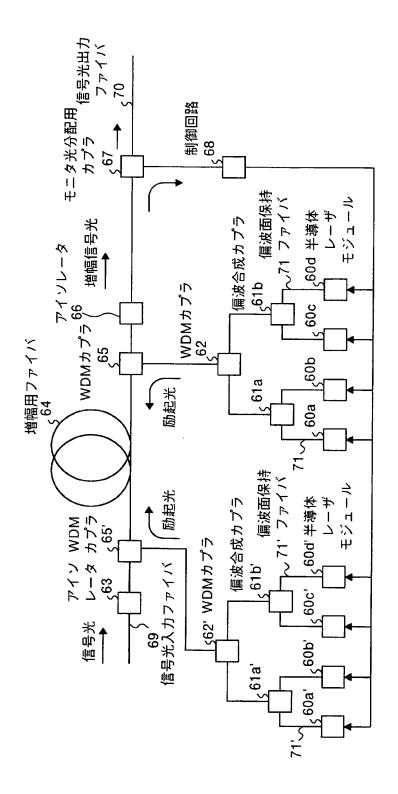
【図25】



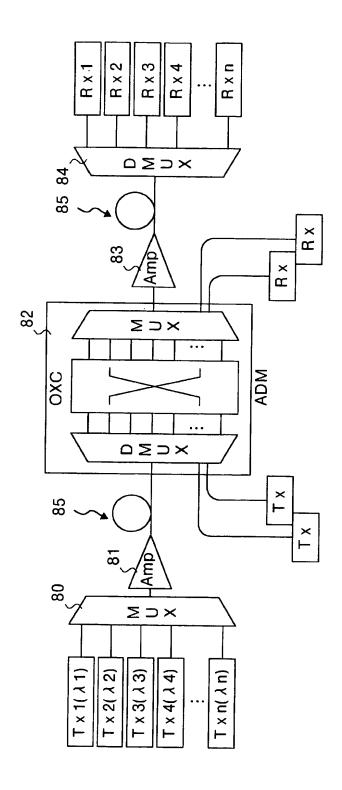
【図26】



【図27】



【図28】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 RINの値が小さい増幅信号光を得ること。

【解決手段】 レーザ光の出射端面に設けた出射側反射膜15と該レーザ光の反射端面に設けた反射膜14との間に形成されたGRIN-SCH-MQW活性層3を有し、複数の発振縦モードをもつレーザ光を出力する半導体レーザ装置において、GRIN-SCH-MQW活性層3に注入されるバイアス電流を変調する変調信号を生成し、該変調信号を前記バイアス電流に重畳する変調信号印加部22を備え、変調信号印加部22は、レーザ光の変調によってレイリー散乱レベルに2dB加えた値以下の値をもつ誘導ブリルアン散乱のリターンロスを与え、伝送後のRINを低減している。

【選択図】 図2

特願2002-207495

出願人履歴情報

識別番号

[000005290]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日 新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

氏 名 古

古河電気工業株式会社